

公益社団法人精密工学会 プラナリゼーションCMP とその応用技術専門委員会
第 161 回研究会開催のご案内

このたび、プラナリゼーション CMP 専門委員会では、下記のとおり【3次元実装】と題して第 161 回研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。なお、研究会終了後、情報交換会を行いますので、是非ご参加下さい。



日 時：2017 年 10 月 26 日（木）13:00～19:00

（研究会・・・13:00～17:15 9F「スズラン」、情報交換会・・・17:15～19:00 8F「スイセン」）

開催場所：プラザエフ（JR 四ッ谷駅麴町口から徒歩 1 分）

東京都千代田区六番町 15（TEL：03-3265-8111）

内 容：

13:00～13:05 開会挨拶（檜山委員長）

13:05～13:10 前回議事録確認

13:10～17:05 話題提供「テーマ：3次元実装」菅井幹事・網島幹事

1) 13:10～13:55 基調講演：コグニティブ時代の先進実装技術

日本 IBM 株式会社 青木豊広氏

<概要>

日々膨大な情報が生成される今日において、それら大量の情報を瞬時に統合し分析するコンピューターシステム、すなわちコンピューターが理解・推論・学習するコグニティブシステムが重要となってくる。今後、このシステムを低消費電力で実現するニューロモーフィックデバイスや、大量のデータを生成するセンサーデバイスのインテリジェンス化が必要となってくるが、本公演では、それらデバイスを実現する先進実装技術について弊社の取り組みを紹介する。

2) 13:55～14:40 基調講演：FO-WLP 開発動向と今後の行方（-2025 までに主役の座を得るのか?-）

株式会社 SBR テクノロジー 代表取締役 西尾俊彦氏

<概要>

InFO がスマホ AP に適用され、FO-WLP が一躍注目を浴びている中で、FO-PLP (FO-WLP のパネルサイズ製造) の開発が再開した。FO-WLP の魅力はどこにあるのか？どのようなアプリが恩恵を受けるのか？パネル製造は成功するのか？成功した先のマーケットサイズは？などの疑問について、現在の開発状況から今後の行方について解説する。

.....
14:40～14:55 コーヒーブレイク
.....

3) 14:55～15:35 産総研における 3 次元集積実装技術の研究開発

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 菊地克弥氏

<概要>

近年の IoT 社会に必要な IoT デバイスでは小型化、低消費電力化、高性能化が要求されている。そのため、シリコン貫通電極 (TSV) を用いた 3 次元集積実装技術は、メモリ積層のような単一機能のデバイスの 3 次元積層のみならず、メモリやロジックなどの複数機能の 3 次元集積実装技術での応用が期待されている。今回は、IoT 社会のさらなる発展に向けて、車載半導体、ビッグデータ処理などへの応用を想定した 3 次元集積実装技術の研究開発における産総研の取り組みについて紹介する。

4) 15:35～16:15 リンテックのチップ薄化プロセス対応材料と装置

リンテック株式会社 田久真也氏

<概要>

携帯電子端末の需要は拡大し、さらなる大容量化／高機能化に向けた要求が高まり、同端末を構成する半導体パッケージの小型化／

薄化技術はますます重要となっている。この実現には、チップ薄化による破断荷重低下を回避する為のチップ強度向上プロセスの導入、および薄化済のチップを安全にハンドリングする装置技術が必要不可欠になる。これらに対応したプロセス、材料、装置に向けたリンテックの提案を紹介する。

5) 16:15～16:55 FO-WLP/PLP に関する取り組み事例紹介

日立化成株式会社 鈴木直也氏

<概要>

近年、半導体デバイス的高速化を達成する実装技術としてFO-WLPが注目されており各社での開発が進んでいる。また、FOパッケージは低コスト化の観点から、ウェハサイズからパネルサイズへ大型化が検討されている。このFO-WLP/PLPを対象として、実装プロセスの確立を目的に、各社協業で組立て上の課題抽出を行った。本報告では、検討事例を含めて取り組み内容を紹介するとともに、今後の展開について紹介する。

16:55～ その他、事務連絡など

17:00～ 閉会の挨拶

17:15～19:00 (情報交換会・懇親会)

参加費：

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円）
2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録）
3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）

※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。

※参加費にはプロシーディング代、懇親会費が含まれます。

※人数確認のため会員の方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。

※準備の都合上、懇親会ご参加有無について必ず記入をお願い致します。

2017年10月26日(木)開催 第161回研究会 参加申込書

会員 / 一般 (いずれかにチェックしてください)

氏名				
勤務先・所属				
参加内容 (参加されるものに○を付けて下さい)	研究会		情報交換会(懇親会)	
連絡先	住所			
	TEL		FAX	
	E-mail			

※新ホームページからオンライン申し込みできます。

<http://www.planarization-cmp.org/registration>

問合せ先：「プラナリゼーションCMP 専門委員会」事務局（三上）
TEL：03-5117-2225, FAX：03-5117-2223, E-mail：mikami@global-net.co.jp